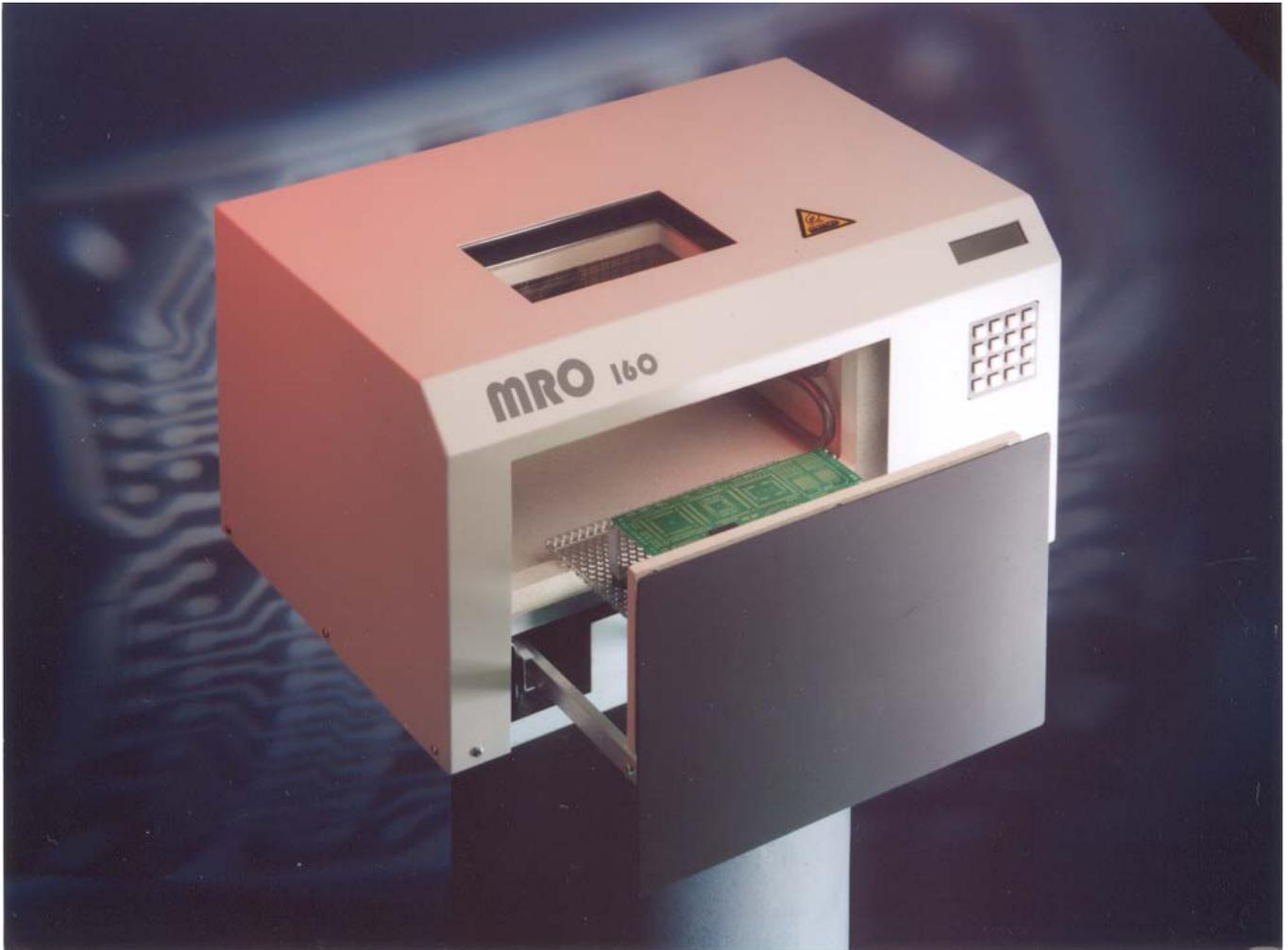


Kompaktes Reflow-Lötsystem

MRO 160 MRO 250



Komfortabel

Die Leiterplattenschublade schliesst sich beim Start des Lötprogramms und öffnet sich automatisch nach Beendigung.

Einsichtig

Jeder Löt- oder Aushärteprozess kann durch das Sichtfenster beobachtet werden.

Schnell

Nach dem Einschalten ist das System sofort bereit zur Eingabe eines spezifischen Temperaturprofils.

Flexibel

Das MRO 160 und MRO 250 Reflow Lötssystem kann für einseitige und doppelseitige SMD Baugruppen wie auch zum Kleber aushärten benutzt werden.

Einfache Bedienung – Präzise Ergebnisse

Die Konvektions Reflow Lötssysteme MRO 160 und MRO 250 sind mit einer Transportschublade ausgestattet in der die Leiterplatte auf Haltern gelagert wird. Die Halter sind durch Magnetfüsse individuell einstellbar.

Durch diese massearme Halterung wird die Baugruppe ohne thermische Belastung optimal im Luftstrom gelagert, so dass eine gleichmässige Temperaturverteilung über die gesamte Leiterplattenoberfläche gewährleistet ist.

Ein Microcontroller übernimmt die vollständige Kontrolle des Heizprozesses und garantiert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.

Die Programmierung und Bedienung erfolgt mit Hilfe einer übersichtlichen Tastatur. Sämtliche Benutzereingaben und die für den Ablauf wesentlichen Betriebsdaten werden auf dem zweizeiligen LCD-Display angezeigt.

Die menügeführte Benutzeroberfläche erlaubt eine einfache und schnelle Bedienung des Systems. Jedes Temperaturprofil wird einer vierstelligen Produktnummer zugeordnet, unter der gleichzeitig auch die Speicherung erfolgt.

Nachdem die vier Parameter (Vorheiztemperatur und Zeit sowie die Löttemperatur und gewünschte Lötzeit) für ein Lötprofil eingegeben wurden, kann der Prozess gestartet werden.

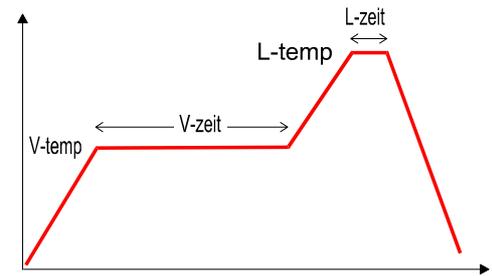
Die gewählte Lötzeit kann bei der Bearbeitung verlängert oder verkürzt werden. Der so ermittelte Wert wird automatisch unter der Produktnummer gespeichert.

Nach Beendigung des Heizvorgangs wird die Schublade automatisch ausgefahren und ermöglicht das Abkühlen der Baugruppe.

Die Energieübertragung zur Baugruppe erfolgt mittels Konvektion. Dadurch wird eine schnelle und gleichmässige Erwärmung gewährleistet und die Bildung von Temperaturschatten und Überhitzung vermieden.

Ein weiterer Vorzug der Konvektionserwärmung sind nur minimale Temperaturunterschiede zwischen kleinen und grossen Bauelementen.

Reflow-Löten von SMD-bestückten Baugruppen sowie das Aushärten von Klebern ist mit dem MRO 160 bzw. MRO 250 einfach und wirtschaftlich. Der geringe Platzbedarf und der äusserst günstige Preis sind weitere Pluspunkte dieser Konvektions Reflow Lötssysteme.



Technische Daten MRO 160

Breite:	480 mm
Höhe:	260 mm
Tiefe:	330 mm
Gewicht:	18 kg
Spannung:	230 V / 50 Hz
Leistung:	2 kW
Max. LP:	200 x 160 mm

Technische Daten MRO 250

Breite:	590 mm
Höhe:	260 mm
Tiefe:	430 mm
Gewicht:	21 kg
Spannung:	230 V / 50 Hz
Leistung:	3,5 kW
Max. LP:	350 x 250 mm

Überzeugende Technik für Labor und kleine Serien
MRO 160 und MRO 250